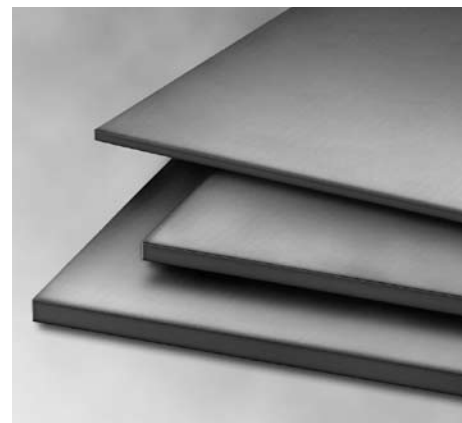


Hexoloy® SA SiC 烧结碳化硅瓷砖



现有标准产品尺寸及公差

瓷砖尺寸 长x宽(mm)	厚度范围 (mm)	长度、宽度公差 (mm)	厚度公差 (mm)
25.40 x 25.40	2.54 to 9.53	±0.25	±0.25
49.99 x 49.99	3.18 to 12.70	±0.38	±0.25
50.47 x 100.94	3.81 to 25.40	±0.38W, ±0.76L	±0.25
100.94 x 100.94	3.81 to 25.40	±0.76	±0.25
107.19 x 107.19	3.81 to 19.05	±0.76	±0.25
156.46 x 40.64	5.08 to 19.05	±1.52	±0.25



模压产品，小批量压制（小于2500片/月）

瓷砖尺寸 长x宽 (mm)	厚度范围 (mm)	长度、宽度公差	厚度公差
342.90 x 242.90	5.08 to 19.05	TBD	TBD

Custom Sizes Available Using Isopress

瓷砖尺寸 长x宽 (mm)	厚度范围 (mm)	长度、宽度公差	厚度公差
最355.60 x 762.00	厚度最大101.60	无数据	无数据

- 弯曲/平面度为0.127 mm/mm
- 烧结表面光洁度最大40 microinch，除非另有说明
- 瓷砖进行清洗，清除油污和残留物
- 每片瓷砖可根据请求进行喷砂处理
- 根据要求，可在瓷砖边缘加上粉末批号追踪标识
- 可提供产品全检（需额外收费）

Hexoloy SA装甲典型性能

物理性能	单位	Hexoloy
成分(相)		SiC
晶粒大小	μm	4-10
密度	g/cm ³	3.13
硬度(努氏, 100克负载)	kg/mm ²	2800
四点抗弯强度 @ 室温, 试样尺寸 3x4x45mm	MPa x 10 ⁶ lb/in ²	380 55
抗压强度@ 室温	MPa x 10 ⁶ lb/in ²	3900 560
弹性模量@ 室温	GPa x 10 ⁶ lb/in ²	410 59
威布尔模量 (两参数)		10
泊松比		0.14
断裂韧性@ 室温 DT法&SENS法	MPa x m ^{1/2} x10 ³ lb/in ² /in ^{1/2}	4.60 4.20
热膨胀系数, 室温至700°C	x 10 ⁻⁶ mm/mmK x 10 ⁻⁶ in/in°F	4.02 2.20
空气中最大使用温度	°C °F	1900 3450
平均比热@ 室温	J/gmK	0.67
热传导率 @室温		125.6 72.6
@200°C	W/mK Btu/ft h°F	102.6
@400° C		59.3 77.5 44.8
电阻 @ 室温* @1000°C	ohm-cm	10 ² -10 ⁸ 0.01-0.2
放射率		0.9

*Hexoloy SA碳化硅中掺杂物会改变其电阻率, 降低到期望的水平

The information recommendations, and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorization to practice a patented invention without a license. Hexoloy® is a registered trademark of Saint-Gobain Ceramics.

圣戈班精细陶瓷(上海)有限公司
上海市华宁路2888弄88号7座, 邮编:
201108
电话: 86 21 6489 9993
传真: 86 21 6442 2667
电子信箱: hexoloy.china@saint-gobain.com
网址: www.hexoloy.com.cn

©2007 Saint-Gobain Ceramics
All Rights Reserved
Form No. B-1053
6/04